

# S3X70-M500C Sn 3.0Ag 0.5Cu

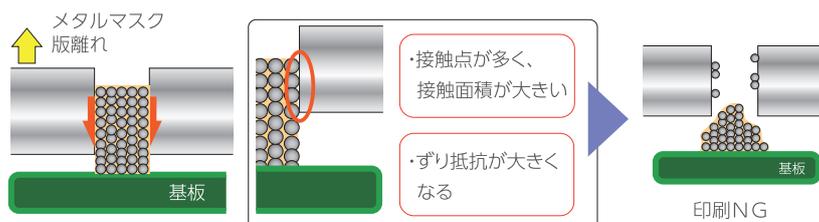
高度な印刷性・溶融性で0402チップ実装を容易に

## 高密度実装対応ソルダペースト

### 微細印刷に対応

粒径の細かいはんだ粉はメタルマスク内壁との接触面積が広く、ずり抵抗が大きくなるため印刷不良が起きやすくなります。

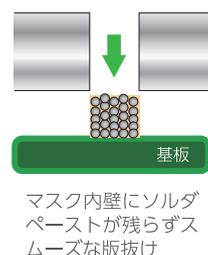
#### ■ 版離れイメージ図



### 版抜け性の向上、安定した印刷形状

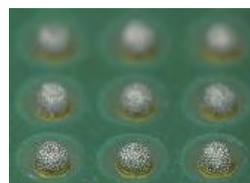
版離れ時のずり抵抗を小さくすることにより、版抜け性が格段に向上、高アスペクト比の印刷が可能となります。

#### ■ 滑剤効果

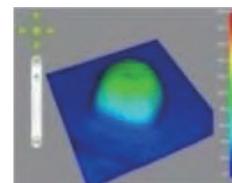


#### ■ 印刷状態 (200 $\mu$ m $\phi$ )

- スキージ: メタル
- 印刷圧: 50N
- スキージ速度: 40mm/sec
- メタルマスク厚: 100 $\mu$ m
- 版離れ速度: 10mm/sec



200ストローク後10枚目



3D image

### 大気リフローでの確実な溶融性

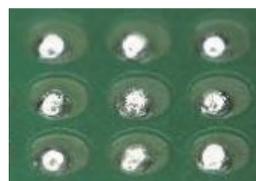
フラックス耐熱性を向上させ、微細パターンにおいても大気リフローでの完璧なはんだ溶融を可能としました。

はんだ粒未溶融例



#### ■ はんだ溶融性

- 基板: ガラスエポキシ FR-4
- 表面処理: Au
- メタルマスク厚: 100 $\mu$ m
- 開口率: 100%
- リフロー雰囲気: 大気



200 $\mu$ m $\phi$



0402チップ

はんだ未溶融が無く、大気リフローでの確実な微細実装が可能

#### ● 製品物性表

製品名	S3X70-M500C	S3X70-M500D <span style="color: red;">HF</span>
合金組成 (%)	Sn 3.0Ag 0.5Cu	
融点 (°C)	217-219	
粉末粒度 ( $\mu$ m)	10-25	
粘度 (Pa·s)	200	100
フラックス含有量 (%)	11.5	14.0
ハライド含有量 (%)	0	
フラックスタイプ	ROLO	
使用用途	印刷用	ディスペンサー用

0402チップ実装対応

11005  
0603  
0402

ファインパターン CSP>0.2mm $\phi$

低ボイド

>48時間

タック時間 >48h

無洗浄タイプ

No-clean